

深圳市江波龙电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-009

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	创金合信
时间	2026年5月6日(周三) 15:30-16:30
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>1、公司为何将端侧 AI 作为未来业务发展的重点？</p> <p>答：公司认为，AI 作为一个整体产业链，云端 AI 的建设后，AI 产业的发展需要打通到端侧，实现产业的正向循环。因此，端侧 AI 有望成为云端 AI 之外的，存储产业另一核心增长动能。为支持本地化大模型加载、实时数据处理等复杂功能，端侧 AI 设备需配备高性能、大容量、低延迟、小体积与定制化的存储产品。公司具备涵盖芯片设计、固件开发、封装测试等存储关键环节的集成存储能力，能够全面适配端侧 AI 存储的多元综合需求。</p> <p>公司已推出 UFS4.1、mSSD、超薄 ePOP5x、超薄 ePOP4x 等多款适配于端侧 AI 设备的新型存储产品。其中，以 UFS4.1 为代表的旗舰存储产品已实现规模化出货；ePOP4x 产品已经批量应用于北美智能穿戴科技巨头的智能穿戴设备中；mSSD 产品，已顺利进入头部 PC 厂商的导入测试阶段，预计将于 2026 年对传统 SSD 产品实现规模化替代。</p> <p>公司已经正式发布 HLC（高级缓存技术）、SPU（存储处理单元）、iSA（存储智能体）等新型技术与软硬件产品。在 AI 全产业普遍面临内存成本高企问题的背景下，公司将以领先技术，助力产业缓解 DRAM 价格高企对端侧 AI 产品的成本压力与大规模普及的制约，把握端侧 AI 落地的历史性机遇。</p> <p>2、HLC 技术是如何实现存储的更高效利用的？HLC 技术有多大的市场空间？</p> <p>答：HLC 技术基于公司自研高性能主控芯片、专属固件与系统级架构的协同配合，让 SSD 或 UFS 存储设备承接原本由 DRAM 负责的温冷数据缓存工作，将高度依赖 DRAM 的缓存负载精准卸载至 NAND 中，在维持系统性能的前提下，能够有效降低终端设备的 DRAM 配置要求。</p> <p>进入 AI 大模型时代，“内存墙”的物理限制与高昂的</p>
---------------------------	--

	<p>内存成本，已成为大模型在端侧 AI 广泛应用的重要阻碍。HLC 技术与配套产品生态，在保证客户体验基本不变的前提下，能够实现 NAND Flash 与 DRAM 整体存储方案在成本和技术优化层面的最优解，具备极为广阔的市场应用前景。HLC 技术目前已经和 AMD、紫光展锐等生态伙伴合作完成技术验证和联合调优，公司正与重要合作伙伴一道，推进相关技术的产品化和市场推广。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>